

证券代码：000021

证券简称：深科技

深圳长城开发科技股份有限公司

2023年9月12日投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	新华资产、建信基金、国金证券、中信证券、东吴证券
时间	2023年9月12日
地点	公司本部会议室
上市公司接待人员姓名	董事长（代）周庚申，董事会秘书钟彦，证券事务代表刘玉婷，公司董办任梅、王梓鑫、邱恺文
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次会议主要介绍了公司概况、核心竞争优势、产业布局以及产品与业务，并就调研投资者关心的公司所处行业动态、三大主营业务情况、未来发展方向等有关问题进行了解答。</p> <p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司是全球领先的专业电子制造企业，连续多年在MMI（Manufacturing Market Insider）全球电子制造服务行业（Electronic Manufacturing Service, EMS）排名前列。公司专注于为客户提供技术研发、工艺设计、生产制造、供应链管理、物流、销售等一站式电子产品制造服务。以先进制造为基础，以市场和技术为导向，公司坚持高质量发展，构建了以存储半导体、高端制造、计量智能终端为三大主营业务的发展战略。</p> <p>二、主要问题及回复</p> <p>1、问：公司在封测领域有哪些竞争优势？</p>

答：在半导体封测业务领域，公司主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括动态随机存取存储器（DRAM）、NAND型闪存（NAND FLASH）以及嵌入式存储芯片。作为国内领先的独立DRAM内存芯片封装测试企业，公司拥有行业经验丰富的研发和工程团队，具备精湛的多层堆叠封装工艺能力和测试软硬件开发能力。

2、电子制造竞争激烈，公司的核心优势是什么？

答：公司在EMS行业深耕38年，具备丰富的规模化制造经验和先进的工程技术能力。在工程技术方面，公司拥有一大批经验丰富的工程技术团队及行业领先的设备，可面向多类电子产品业务。

3、计量智能终端的产品分布情况，境内外收入占比分别是多少？

答：凭借先进的技术和专业的服务，行业领先的创新优势和过硬的品质，公司赢得了国内外客户的长期信赖，与欧洲、非洲、亚洲、南美洲、中东地区的多个国家级能源事业单位客户建立合作关系；2023年上半年，公司的智能计量业务在海外市场拓展方面持续向好，中标意大利智能表计项目，与乌兹别克斯坦区域电网公司签署计量系统双边运维协议；同时在国家电网有限公司电能表(含用电信息采集)招标采购项目再次中标。2023年上半年，公司计量智能终端业务中，境外市场营收占营业收入总额85.39%，境内市场营收占营业收入总额14.61%。

4、公司半年报中显示存货较去年年底有明显下降，主要是什么原因？

答：公司重视供应链稳定与存货风险情况。2022年由于供应链相对紧张，公司进行了一定的备货准备。2023年上半年，公司供应链紧张局势逐渐缓解，存货规模有所压降。

5、公司2022年股票期权激励计划是否有完成压力？

答：公司2022年股票期权激励计划对2023年的考核目标为：（1）2023年净资产现金回报率（EOE）不低于13.00%，且不低于2023年同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平；（2）以2021年为基数，2023年净利润复合增长率不低于10.00%，且不低于2023年同行业平均业绩水平或对标企业75分位值水平；（3）2023年营业利润率不低于3.40%。

考核目标对公司既是压力也是动力，公司将力争提高自身经营效益和

	<p>业绩表现，努力达成既定目标。</p> <p>接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年9月13日